

Способ относится к радиоэлектронике, а именно к технологическим способам изготовления теплопроводных печатных плат с термокомпенсацией, которые подвергаются действию тепловых, ударных и вибрационных нагрузок. Способ изготовления теплопроводной печатной платы с термокомпенсацией включает образование ее структуры путем последовательного размещения по меньшей мере на одной стороне металлической основы соответственно первого адгезива, эластичного материала, второго адгезива и печатной платы, с предварительно сформированным на ней рисунком коммутационных проводников, со следующим соединением образованных элементов структуры между собой путем действия температуры и давления. Рисунок формируют по меньшей мере на двухслойной печатной плате и на сформированные коммутационные проводники рисунка платы, со стороны металлической основы, наносят слой металла, твердость которого по Бринеллю составляет $15 \div 100$ МПа. В качестве адгезива, расположенного между эластичным материалом и печатной платой, используют материал с твердостью по Бринеллю ≤ 15 МПа в диапазоне температур $+90 \div +190$ °С. Твердость металла, нанесенного на коммутационные проводники рисунка платы, больше твердости адгезива, расположенного между эластичным материалом и печатной платой, и меньше твердости эластичного материала при температуре $+90 \div +190$ °С. Суммарная толщина адгезивов и размещенного между ними эластичного материала больше или равна высоте коммутационных проводников с нанесенным на них слоем металла с низкой твердостью. Изобретение позволяет расширить область применения и эксплуатационные возможности, увеличить выход пригодных плат и уменьшить себестоимость изготовления.